

トレックス・セミコンダクター株式会社
品質保証部

成分表

製品名(鉛フリー): XC6701DxxxJR-G
標準質量: 320 mg

名称	質量(mg)	物質名称	構成比率(ppm)	CAS No.
シリコンチップ	0.925	シリコン	2900	7440-21-3
リードフレーム	168.780	銅	527400	7440-50-8
	0.135	鉄	400	7439-89-6
	0.034	リン	100	7723-14-0
	0.101	銀	300	7440-22-4
ダイアタッチ	0.371	銀	1200	7440-22-4
	0.063	アクリル樹脂	200	—
	0.029	ポリブタジエン誘導体	100	—
	0.019	エポキシ樹脂	100	—
ボンディングワイヤ	0.035	金	100	7440-57-5
封止樹脂	125.201	溶融シリカ	391300	60676-86-0
	16.356	エポキシ樹脂	51100	—
	7.137	フェノール樹脂	22300	—
端子メッキ	0.812	錫	2500	7440-31-5

※ 成分組成は、ベンダーからの情報を元に算出しております。機密情報保持の為、
開示されない情報があり、全内容を保証するものではありません。

※ 質量、構成比率については、材料等の製造条件によって異なることがあります。

※ CASNo.欄で「-」と表記された物質は、社外秘とさせて頂いております。